



平成 26 年 8 月 11 日

各 位

上場会社名 株式会社 新 川
代 表 者 代表取締役社長執行役員 長野 高志
(コード番号 6274 東証第一部)
問合せ先責任者 取 締 役 執 行 役 員
経営企画部長兼経理部長 森 琢也
(電話番号 042-560-4848)

平成 27 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 27 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想を下記の通りお知らせいたします。

記

平成 27 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想数値（平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 9 月 30 日）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期 純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	—	—	—	—	—
今 回 修 正 予 想 (B)	6,200	△1,310	△1,370	△1,380	△75.93
増 減 額 (B-A)	—	—	—	—	—
増 減 率 (%)	—	—	—	—	—
(ご参考) 前期第 2 四半期実績 (平成 26 年 3 月期第 2 四半期)	4,076	△1,835	△1,762	△1,763	△97.00

業績予想の概要

半導体業界においては、引き続きモバイル関連や車載関連の需要が拡大し、半導体メーカー各社による量産対応の設備投資が増加すると予想されています。また、ローエンドおよびミドルエンドモデルのモバイル機器の拡大に伴う汎用半導体のコスト競争に対応するため、銅線や銀線ボンディングへの移行に向けた設備投資の増加も見込まれます。

一方で、東欧・中東情勢の緊迫化や米国の量的緩和縮小に伴う新興国の経済不安など、半導体需要を左右する世界経済の下押し要因も散見されます。

このような状況のもと、当社グループは、新製品群の拡販に加え、新体制によるグローバル・オペレーションの定着や外部パートナーとのアライアンスを活用した研究開発の推進など、グローバル競争力強化の取り組みを継続しています。

直近の受注状況など、現時点において当社グループが把握する情報に基づき、第 2 四半期連結累計期間の業績予測を開示します。

なお、為替の想定換算レートは、100円/米ドルです。

※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社グループとして約束する趣旨のものではありません。また実際の業績等は、様々な要因により、本資料における記述と大きく異なる可能性があります。

以 上